Approved For Release : CIA-RDP62-00647A000100060096-1

S. List Policy

66

S E C R E T

23 décembre 1959

Doct. COCOM 3715.NA 1/2

COMITE DE COORDINATION

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS

SUR

LE NOUVEL ARTICLE ELECTRONIQUE No. 1

Le 18 décembre 1959

Présents : Allemagne, Belgique (Luxembourg), Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni.

Références : Docts. COCOM 3700.5, 3715.00/1, 3715.NA 1/1 et Nouvel Article No.1/ D.T.1 révisé.

Toutes les délégations ayant confirmé leur accord, préalablement donné ad referendum, à la proposition des Etats-Unis relative au nouvel article électronique No.1., le COMITE convient d'inscrire en Liste I le nouvel article suivant :

"Matériels et pièces électroniques non dénommés ailleurs :
(a) ensembles et sous-ensembles constituant un circuit fonctionnel ou plus et ayant une densité d'éléments de plus de 75 parties par pouce^3 (...parties par cm^3) et matériels incorporant de tels ensembles ou sous-ensembles
(b) panneaux isolants modulaires (y compris les plaquettes) supportant des éléments électroniques simples ou multiples ; et leurs pièces spécialisées".

S E C R E T

S E C R E T

23rd December, 1959.

COCOM Document 3715.NI 1/2B

COORDINATING COMMITTEE

RECORD OF DISCUSSION

ON

NEW ELECTRONICS ITEM No.1

18th December 1959

Present: Belgium(Luxembourg), Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, United Kingdom, United States.

References: COCOM Docs. 3700.5, 3715.00/1, 3715.NI 1/1 and New Item 1/W.P. 1 Revised.

All Delegations having confirmed their agreement previously given ad referendum to the United States proposal concerning New Electronics Item No.1, the COMMITTEE agreed to add the following new item to International List I.

"Electronic equipment and components, n.e.s. the following:
(a) Assemblies ans sub-assemblies constituting one or more functional circuits with a component density greater than 75 parts per cubic inch (... parts per cubic centimetre), and equipment containing such assembly or sub-assembly;
(b) Modular insulator panels (including wafers) mounting single or multiple electronic elements and specialised parts therefor."

Approved For Release : CIA-RDP62-00647A000100060096-1

S E C R E T